

フッ素樹脂 ネオフロン EFEP RP-5000AS

 TECHNICAL
DATASHEET

ネオフロン EFEP RP-5000AS は、ETFE 並みの耐薬品性を有しながらポリアミドなどの汎用樹脂との接着を可能にしたフッ素樹脂の導電グレードです。

概要

- ネオフロン EFEP RP-5000AS は、ETFE に第三のフッ素系成分を主鎖中に導入することにより**低融点化**を可能にしたフッ素樹脂で導電性を有しています。
- EFEP の接着性官能基がポリアミドなどの汎用樹脂と化学反応することにより**溶融接着が可能**です。
- 低融点化により、**EVOH などとの共押出**が可能となりました。
- ETFE 並みの**耐薬品性**、**良好な成形加工性**を有するフッ素樹脂です。
- 成形については、**押出成形**や**射出成形**や**圧縮成形**などが可能です。

一般物性

項目	単位	数値	試験方法
MFR	g/10min	4	265°C、49N
融点	°C	195	ASTM D 3159
比重	-	1.76	ASTM D 3159
引張強度	MPa	40	ASTM D 638
引張伸度	%	290	ASTM D 638
引張弾性率	MPa	1100	ASTM D 638
抵抗値	MΩ	0.2	DAIKIN 測定法 (insulation resistance tester, 7cm long)

*上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 50kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-rp-5000as-J_ver03_Aug_2021
Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2021